

■封面故事

- 技術生態兩極化趨勢確立台灣IC產業擴大全球佈局
- 先進製程推升算力需求雲端EDA帶來靈活性與彈性
- 雲端部署引領IC設計邁向全自動化
- EDA雲端化一舉解決IC設計痛點

■編者的話

- 時也·命也·財也

■新聞分析

- 拉AMD加入戰局5G手機市場三星贏了一小步
- 4D列印技術將徹底改變製造的產業形式
- 手擒數據 - 感測技術促進行動健康照護應用

■產業觀察

- 淺談量子位元與量子電路
- 2020年汽車電子產業趨勢
- 企業建置資安防護措施刻不容緩

■產業視窗

- 工研院攜手博晟生醫研發有成 打造「膝」望更樂活
- AI晶片設計平台助攻AI晶片設計平台助攻
- 鏖創：Micro LED成本5年內下降95%

■焦點議題

- 微縮實力驚人 台積3奈米續沿用FinFET電晶體製程

■獨賣價值

- 電子製造與雲端服務雙管齊下 新創立足行動醫療市場

■透視智慧物聯

- AIoT架構複雜 混合雲成為入手最佳解

■矽島論壇

- 新冠肺炎疫情推動電子產業聚落在地成形

■專題報導-人工智慧

- 新型態競爭風雲起 EDA啟動AI晶片新戰場
- 邊緣持續發酵 AI邁出應用新步調

■量測進化論 - 頻譜分析儀

- 正確選擇頻譜分析儀 信號分析不用愁

■關鍵技術報告 - 嵌入式設計

- CrossLinkPlus FPGA簡化基於MIPI的視覺系統開發
- 車輪速度感測器的重要性

■亭心觀測站

- 仿生晶片的能與不能

■科技有情

-資料環遊世界：空運還是陸運？